

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】令和4年11月8日(2022.11.8)

【公開番号】特開2022-69413(P2022-69413A)

【公開日】令和4年5月11日(2022.5.11)

【年通号数】公開公報(特許)2022-082

【出願番号】特願2021-170961(P2021-170961)

【国際特許分類】

C 22 C 9/00(2006.01)

10

H 01 B 5/00(2006.01)

C 22 F 1/00(2006.01)

C 22 F 1/08(2006.01)

【F I】

C 22 C 9/00

H 01 B 5/00 Z

C 22 F 1/00 6 0 4

C 22 F 1/00 6 1 3

C 22 F 1/00 6 2 3

C 22 F 1/00 6 3 0 A

20

C 22 F 1/00 6 3 0 K

C 22 F 1/00 6 5 0 A

C 22 F 1/00 6 6 1 A

C 22 F 1/00 6 8 1

C 22 F 1/00 6 8 2

C 22 F 1/00 6 8 3

C 22 F 1/00 6 8 5 A

C 22 F 1/00 6 8 5 Z

C 22 F 1/00 6 9 1 A

30

C 22 F 1/00 6 9 1 B

C 22 F 1/00 6 9 1 C

C 22 F 1/00 6 9 2 A

C 22 F 1/00 6 9 4 A

C 22 F 1/00 6 9 4 B

C 22 F 1/08 B

C 22 F 1/00 6 9 1 Z

【手続補正書】

【提出日】令和4年10月28日(2022.10.28)

【手続補正1】

40

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

エッジワイス曲げ加工が施されるスリット銅材であって、

Cuの純度が99.96mass%以上であり、板幅Wと板厚tとの比W/tが1.0以上とされ、

導電率が97.0%IACS以上とされ、

板厚中心部の平均結晶粒径Aと板厚表層部の平均結晶粒径Bとの比B/Aが0.80以

50

上 1 . 2 0 以下の範囲内とされ、

前記板厚中心部の平均結晶粒径 A が 2 5 μm 以下とされていることを特徴とするスリット銅材。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 8】

本発明は、上述の知見に基づいてなされたものであって、本発明の一態様に係るスリット銅材は、エッジワイス曲げ加工が施されるスリット銅材であって、Cu の純度が 99.96 mass % 以上であり、板幅 W と板厚 t との比 W / t が 10 以上とされたスリット銅材であって、導電率が 97.0 % IACS 以上とされ、板厚中心部の平均結晶粒径 A と板厚表層部の平均結晶粒径 B との比 B / A が 0.80 以上 1.20 以下の範囲内とされ、前記板厚中心部の平均結晶粒径 A が 25 μm 以下とされていることを特徴としている。 10

20

30

40

50